STANDARDLAGENAUFBAU HDI

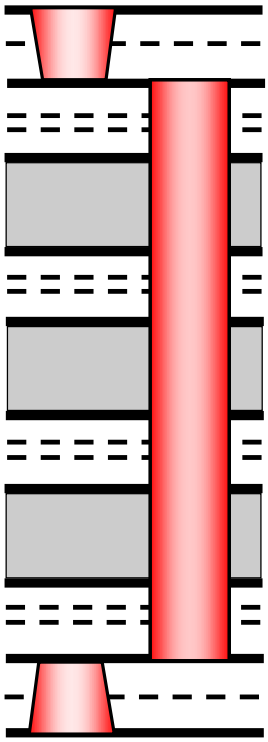
HDI10_1+8b+1_1,50_35

10 - Lagen

Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 8B + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	9 µm		30	
					2 x 1080	133	
3	2			35 µm		33	
			0,200 mm			200	
4	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
5	4			35 µm		33	
			0,200 mm			200	
6	5			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
7	6			35 µm		33	
			0,200 mm			200	
8	7			35 µm		33	
					2 x 1080	133	
9	RSK1			9 µm		30	
					1 x 1080	60	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1516

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,12	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,15	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,17	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	Seite:	11+